

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2025-027

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司结合全球市场副总裁邵丹先生的任职履历，以及对公司多个主要产品线业务发展及研发项目的领导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。
- 考虑到公司原核心技术人员李强先生现担任公司控股子公司上海聚栋半导体有限公司总经理职务，不再参与具体研发项目，公司不再认定李强先生为公司核心技术人员。
- 上述核心技术人员调整不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生影响。

#### 一、核心技术人员调整的具体情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）结合全球市场副总裁邵丹先生的任职履历，以及对公司多个主要产品线业务发展及研发项目的领导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。同时，考虑到公司原核心技术人员李强先生现担任公司控股子公司上海聚栋半导体有限公司总经理职务，不再参与具体研发项目，公司不再认定李强先生为核心技术人员。

##### 1、新认定核心技术人员情况

邵丹，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，成都信息工程大学通信工程专业学士。邵丹先生于2004年9月至2006年4月任上海凌阳科技有限公司应用工程师；2006年4月至2009年11月先后任芯成半导体（上海）有限公司应用工程师、软件开发经理、现场应用经理；2009年11月至今先后担任本

公司现场应用总监、资深现场应用总监、资深市场总监、全球市场副总裁等职务。邵丹先生参与制定本公司主要产品线的战略发展方向，为多个产品线的技术升级和设计改进制定了具体规划及要求，对公司产品的持续发展起到重要作用。

在公司工作期间，邵丹先生作为第一发明人研发本公司《REVERSIBLE WRITE-PROTECTION FOR NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE》美国发明专利，以及《串行非易失性存储器及解除存储器写保护的方法》、《射频识别系统的保护方法》、《具有加密保护的近场通信标签及适用的近场通信控制系统》、《一种内置近场通讯标签芯片及 EEPROM 的集成芯片》4 项实用新型专利，并参与研发本公司《用于 24 系列 EEPROM 的写保护电路》实用新型专利。具体如下：

| 序号 | 发明名称                                                                     | 专利号            | 发明人        | 申请人 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|
| 1  | REVERSIBLE WRITE-PROTECTION FOR NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE | US8,843,695B2  | 邵丹、郝清山、徐红如 | 公司  |
| 2  | 串行非易失性存储器及解除存储器写保护的方法                                                    | 201110350626.1 | 邵丹、郝清山、徐红如 | 公司  |
| 3  | 射频识别系统的保护方法                                                              | 201310011430.9 | 邵丹         | 公司  |
| 4  | 具有加密保护的近场通信标签及适用的近场通信控制系统                                                | 201420755678.6 | 邵丹、焦双南     | 公司  |
| 5  | 一种内置近场通讯标签芯片及 EEPROM 的集成芯片                                               | 201420672334.9 | 邵丹、焦双南、谈方兵 | 公司  |
| 6  | 用于 24 系列 EEPROM 的写保护电路                                                   | 201520037542.6 | 焦双南、邵丹     | 公司  |

## 2、原核心技术人员情况

李强，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华中科技大学微电子专业硕士。李强先生于 1998 年 7 月至 2002 年 10 月任上海贝尔阿尔卡特有限公司研发部 IC 设计主管；2002 年 11 月至 2007 年 5 月任上海正微电子有限公司技术总监；2007 年 5 月至 2008 年 9 月任上海华虹集成电路有限责任公司市场部市场经理；2008 年 9 月起任芯成半导体（上海）有限公司市场经理；2009 年 11 月至今先后担任本公司资深市场总监、市场销售副总经理、上海聚栋半导体有限公司总经理等职务。

截至本公告披露之日，李强先生未作为发明人参与本公司专利的申请。

## 二、核心技术人员调整对公司的影响

### （一）研发实力与持续经营能力

公司通过多年的自主研发及业务经营培养了一支积累了产品研发、生产工艺、质量控制等经验的稳定研发团队。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 178 人，占员工总人数比例为 55.28%。本次核心技术人员调整完成后，公司核心技术人员变更为傅志军、王上、陈君飞、李圣均和邵丹，公司核心技术人员及研发团队将持续投入对产品与技术的研发工作。

### （二）专利与核心技术

截至本公告披露之日，公司研发人员在本公司工作期间作为发明人申请的专利及在审专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷的情形，本次核心技术人员调整不会影响公司专利权与核心技术的完整性。

### （三）持续经营能力

截至本公告披露之日，公司的采购、生产及销售工作均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日